

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司为参股公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证参股公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月6日召开第四届董事会第二十六次会议，于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。公司参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币90,000万元的综合授信。公司及参股公司的其他各方股东拟按各自持股比例为上述综合授信提供授信担保。公司持有芯东进45.4545%股权，因此本次担保金额不超过人民币40,909.05万元。具体内容详见公司2026年3月10日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

二、本次担保情况

根据并购及业务发展需要，公司参股公司芯东进与中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“银团”）签署《中国银行业协会银团贷款合同》（以下简称“贷款合同”），申请总计本金额不超过人民币70,000万元的贷款额度。公司与银团于近日签署《中国银行业协会银团贷款保证合同》（以下简称“保证合同”）。公司根据45.4545%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证，担保金额为贷款合同项下本金人民币31,818.15万元及所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。芯东进的其他各方股东均按各自持股比例为芯东进此次贷款提供连带责

任保证。芯东进为公司上述担保事项提供反担保。

截至本公告披露日，公司实际为芯东进提供担保额度总额共计人民币 31,818.15 万元（实际使用额度 0 元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：合肥芯东进新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MAK1XA8025

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 12 月 8 日

注册地址：安徽省合肥市新站区站北社区大禹路 699 号 TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目 1 幢厂房 101-07 室

法定代表人：崔芳鑫

注册资本：44,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；数字技术服务；企业管理咨询；企业管理；安全咨询服务；社会经济咨询服务；商务秘书服务；品牌管理；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；工业工程设计服务；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务等（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（具体经营范围以市场监督管理部门公示为准）

关联关系说明：公司董事会秘书潘大圣先生担任芯东进董事兼总经理职务，公司财务负责人朱静女士担任芯东进财务负责人职务。公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理王照忠先生控制的翰博控股集团有限公司持有芯东进 10%的股权。截至本公告披露日，芯东进未以直接或间接方式持有公司股份，公司持有其 45.4545%的股权。

股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
翰博高新材料（合肥）股份有限公司	20,000	45.4545%
北京芯进科技有限公司	15,600	35.4545%
翰博控股集团有限公司	4,400	10.0000%
青岛初芯瑞伯创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000	9.0910%
合计	44,000	100%

主要财务指标：芯东进成立于 2025 年 12 月 8 日，截至本公告披露日，芯东进尚未开展经营活动，暂未形成相关财务数据。

信用情况：芯东进不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

借款人：合肥芯东进新材料科技有限公司；

贷款人 1：中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行；

贷款人 2：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：贷款合同项下本金人民币 318,181,500.00 元（金额大写：人民币叁亿壹仟捌佰壹拾捌万壹仟伍佰元整）及所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：本合同项下的保证期间为本合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。

保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余 额 (万元)	公告披露日 期	是否资产负 债率超过 70%
重庆博硕光电有限公司	19,000	13,469	2024/11/20	否
	11,000	10,137	2026/1/30	
	3,000	2,000	2026/3/18	
	6,000	0	2026/2/13	
	5,000	0	2026/2/13	
	6,000	3,196	2023/5/22	
	2,000	2,000	2026/2/13	
小计	52,000	30,802	-	
博讯光电科技（合肥）有限公司	13,000	8,919	2024/4/18	是
	10,000	8,750	2022/1/27	
	10,000	8,778	2024/2/23	
	7,000	5,190	2025/4/11	
	10,000	5,700	2025/5/28	
	10,000	9,996	2025/10/28	
	7,800	5,911	2024/4/9	
	10,000	6,000	2024/12/12	
	20,000	13,186	2025/9/10	
	6,000	5,000	2025/12/19	
小计	103,800	77,430	-	
合肥星辰新材料有限公司	2,000	1,487	2024/3/19	否
	500	500	2026/1/30	
	500	500	2025/6/23	
小计	3,000	2,487	-	
博晶科技（滁州）有限公司	150,000	99,529	2022/4/29	是
	5,000	3,919	2025/3/20	
	5,000	4,950	2025/6/23	
	2,000	0	2025/8/13	
	3,000	0	2025/8/13	
小计	165,000	108,398	-	
博昇科技(滁州)有限公司	5,000	4,299	2025/6/23	是

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余 额 (万元)	公告披露日 期	是否资产负 债率超过 70%
小计	5,000	4,299	-	
青岛欧迅光电有限公司	1,000	1,000	2025/3/20	否
小计	1,000	1,000	-	
重庆翰博显示科技有限公司、重 庆翰博显示科技研发中心有限公 司（注1）	27,500	19,038	2020/10/13	是
小计	27,500	19,038	-	
合肥芯东进新材料科技有限公司	31,818	0	本次新增	不适用
小计	31,818	0	-	
合计	389,118	243,454	-	-

注1：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江投资公司”）于2020年10月22日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同债务结束。

注2：若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总金额为46.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为441.88%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总金额为38.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为373.38%，实际担保余额为24.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为233.61%。其中，为参股公司签署的担保合同处于有效期内的担保总金额为31,818.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.53%，实际担保余额为0元。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

- 1、《中国银行业协会银团贷款保证合同》；
- 2、《反担保协议》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026年4月1日